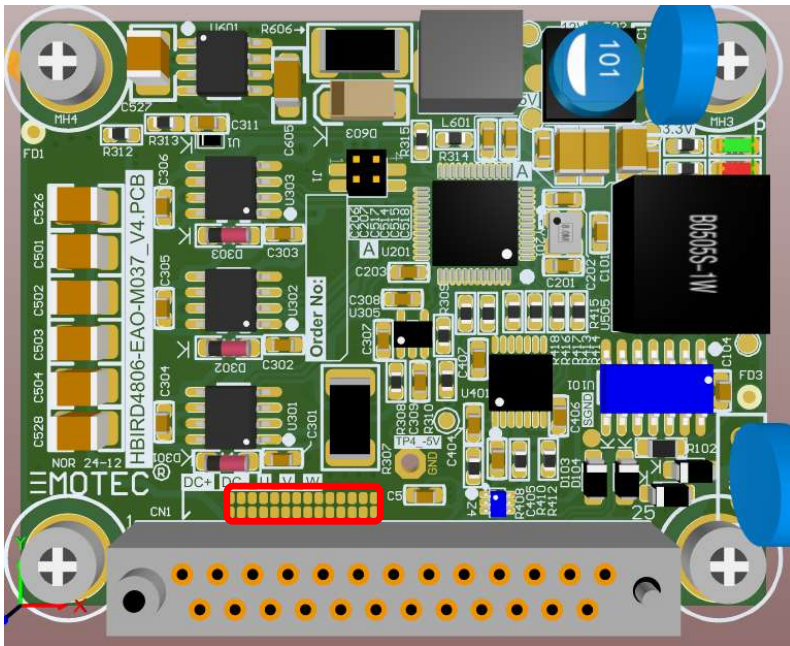


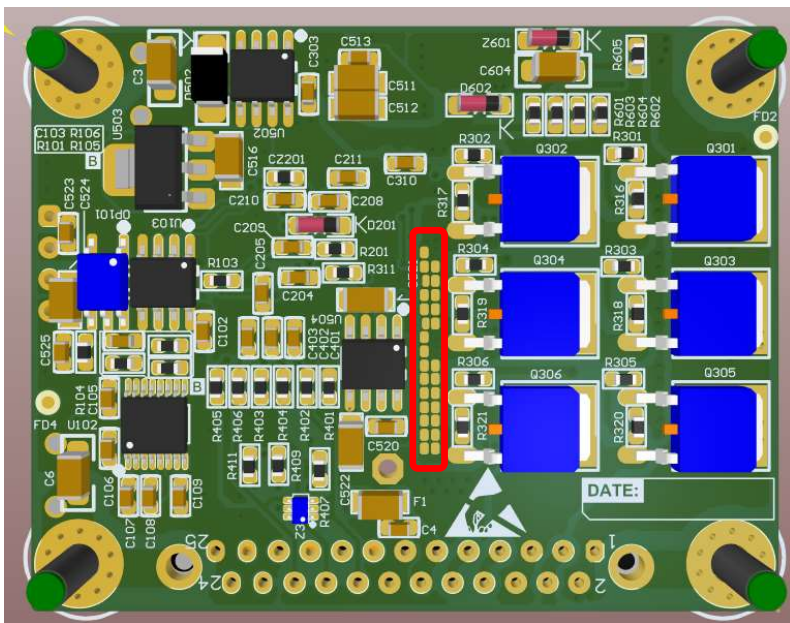
PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	HBIIRD4806-EAO-M037_V4	焊接	QM033241211	V4	1/2	20211211

1. HBIIRD4806-EAO-M037_V4 加锡位置

顶层



底层

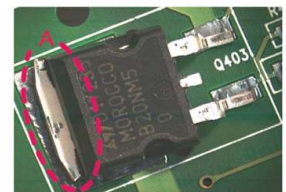


框内 PAD 加锡，加锡厚度为 0.2mm;

2. 焊接基本要求

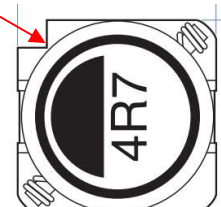
1) 功率管 Q301~Q306 共计 6 个 (TO-252 封装的管子)

- a) 散热面端子 (A) 的侧面偏移不大于端子宽度的 10% (约 0.6mm, 右图为焊接不良图片)。
- b) 散热面末端端子连接宽度在与焊盘接触区域有 100% 润湿



2) L502 电感贴装有方向要求 **【若电感无此缺口，就不分方向极性】**

L502 电感本体缺口与丝印**缺口对应**贴装焊接 **【箭头所指】**

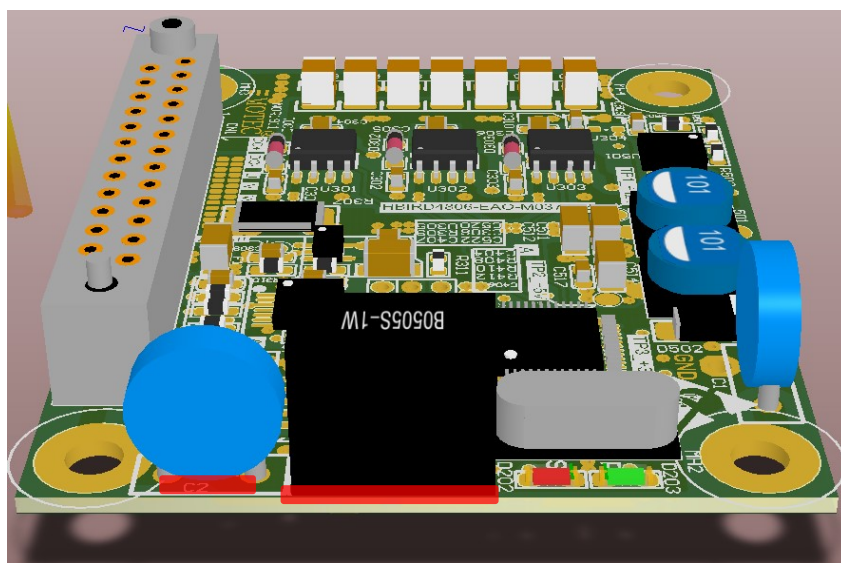
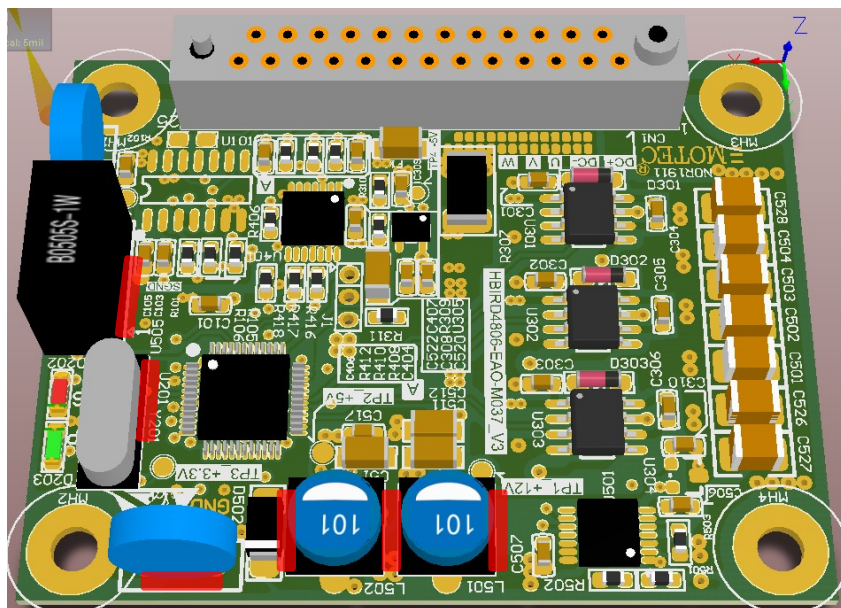


PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	HBI RD4806-EAO-M037_V4	焊接	QM033241211	V4	2/2	20211211

2) U505 及 CN1 端子焊接后, 管脚剪切后, 管脚长度不超过 1.2mm;

3) 点固定胶(黑色 704 固定胶), 点胶厚度为 1.5mm

红色半透明色块区域为点胶位置分布图, 注意点胶不能污染或涂覆到螺钉固定孔, 测试点及 LED 指示灯



4) 所有端口插座焊接需要压到底焊接, 不接受歪扭, 偏差要小于 0.3mm;

5) 所有极性元件, 严禁方向反;

6) 不接受虚焊, 空焊, 焊锡短路;

7) 未特殊说明的元件, 均紧贴线路板焊接;

8) 不可用裸露的手或手指接触可焊表面。人体油脂和盐分会降低可焊性, 加重腐蚀, 还会导致后续的涂覆或封装的粘着性变差。

9) 要做防静电处理;

10) 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准;

11) 贴装元件位置图详见焊接丝印图文件;

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	